

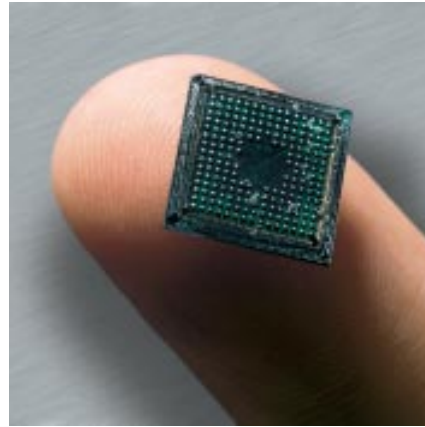
LPKF ZelPlace BGA



LPKF ZelPlace BGA – perfekte Handhabung für Bauteile der neuen Generation. Bestückung von hoch-integrierten Leiterplatten



LPKF ZelPlace BGA mit Monitor



BGA Bauteil

Produktbeschreibung

Die Platzierung von Bauteilen mit versteckten Anschlüssen erfordert wegen teurer Inspektionssysteme und schwieriger Reparaturmöglichkeiten eine verlässliche und präzise Ausrichtung.

LPKF ZelPlace BGA ist für die exakte Platzierung verschiedener Typen von BGA, CSP und Flip Chip Bauteilen, sowie für Fine-Pitch und Ultrafine-Pitch Bauteile ausgelegt. Das System eignet sich sowohl für Entwicklungslabors als auch für die Serienfertigung im Bereich Leiterplattenbestückung.

Eine spezielle Optik und regelbare zweifarbige Beleuchtung ermöglichen es dem Bediener, gleichzeitig die Anschlüsse auf der Leiterplatte und auf dem Bauteil zu kontrollieren und auszurichten. Grob- und Feinjustierung werden durch den Einsatz eines Luftlagerstisches und der Mikrometerschrauben erzielt.

Sobald das Bauteil ausgerichtet ist, kann es durch einen einzigen Knopfdruck leicht platziert werden.

Produktmerkmale

- Platzierung von BGA und QFP Bauteilen von 5 mm x 5 mm (0,2" x 0,2") bis 45 mm x 45 mm (1,77" x 1,77")
- Granit Grundplatte
- Luftgelagerter Positionierungstisch
- Prüfung nach Platzierung



Platzierung von Bauteilen mit CCD Kamera und Monitor

Technische Daten LPKF ZelPlace BGA	
Art.-Nr.	111433
Max. Leiterplattengröße	220 mm x 300 mm
Max. Bauteilgröße	45 mm x 45 mm
Min. Bauteilgröße	5 mm x 5 mm
Raster	Rastermaß 0,3 mm
Positionierungsgenauigkeit	± 50 µm
Anschlusswerte	230 V/50 Hz
Druckluft	6 bar, min. 5 l/min, ölfrei
Abmessungen (B/H/T)	600 mm x 430 mm x 435 mm
Gewicht	35 kg

